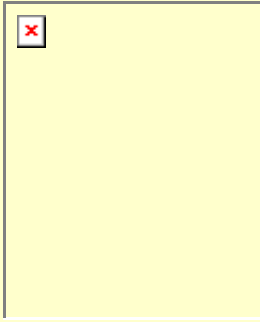


本期封面



2000年1

栏目:

DOI:

论文题目: 活性填料在制备陶瓷基复合材料中的应用

作者姓名: 陈朝辉, 谢征芳, 周长江

工作单位: 国防科技大学

通信作者: 陈朝辉

通信作者Email:

文章摘要: 研究了Ti、TiH<sub>2</sub>等活性填料在聚碳硅烷先驱体裂解制备SiC陶瓷材料中的应用. Ti、TiH<sub>2</sub>等可增加聚碳硅烷的裂解陶瓷产率, 可与N<sub>2</sub>气氛反应生成氮化物, 导致体积膨胀而降低陶瓷的气孔率, 提高材料性能.

关键词: 活性填料; 聚碳硅烷; 先驱体; 裂解

分类号:

关闭